深圳市信维通信股份有限公司

2025年度董事会工作报告

一、报告期内公司从事的主要业务

坚守公司使命，为客户创造价值。公司始终坚守“致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值”的使命，以材料为核心，通过对研发的持续投入，保持与国内、外知名大学和科研院所的合作与交流，加大对基础材料、基础技术的研究和积累，并以材料驱动业务发展，不断深化“材料->零部件->模组”的一站式研发创新能力，为客户提供更丰富的产品和解决方案。

践行公司核心价值观，实现可持续发展。公司坚持以本分、客户满意、结果导向、追求极致、勇于担当为核心价值观，共识、共创、共担、共享，打造有战斗力的合伙人团队，通过多年与客户建立的良好合作关系以及持续的新业务拓展，实现可持续发展。在聚焦主业上，公司始终保持着较强的战略定力及战略落实、推进力，夯实消费电子核心领域业务的同时，积极挖掘新兴领域机会，布局具有前景的新兴产业项目，努力把产业做透做强，在市场波动以及持续动荡的外部环境中，为公司的长期健康发展积蓄力量，不断获得新的成长动能。

报告期内，公司主营业务包括天线及模组、无线充电及模组、EMI\EMC器件、高精密连接器、声学器件、汽车互联产品、被动元件等产品，可广泛应用于消费电子、商业卫星通信、智能汽车、物联网/智能家居等领域。

信维通信是一家全球研发、运营、销售的公司，业务与客户已遍及全球。迄今，公司在全球拥有26家子公司、11个研发中心和5个主要生产基地，员工14,764人，业务覆盖7个国家17个地区。

二、经营情况概述

2025 年度，全球消费电子市场在技术迭代与政策扶持下呈现复苏态势，中国经济也在稳增长举措推动下逐步企稳。公司紧扣产业发展趋势，坚定立足自身的技术积淀，一方面夯实消费电子等第一增长曲线，另一方面加速向 AI 终端、商业卫星、智能汽车、机器人等新兴赛道拓展，不断拓宽第二增长曲线业务规模，全力朝着“产品领先+运营卓越”的技术驱动型平台企业方向稳步迈进。

报告期内，公司整体经营表现稳健，实现营业收入 890,977.98 万元，较上年同期实现增长 1.90%；归属于上市公司股东的净利润达到 70,868.63 万元，同比增长 7.12%；扣除股份支付影响后的净利润达到 73,898.85 万元，同比增长 10.50%；扣除非经常性损益的净利润达到 64,336.03 万元，同比增长 19.56%，同时毛利率提升至 22.79%，较上年增加 1.97 个百分点。公司持续加大重要战略产品研发投入、优化产品结构，通过逐步淘汰低毛利率产品，扩大高附加值新产品营收占比，稳步提升整体盈利水平，推动经营效率持续增强。报告期内，公司资产负债率为 41.43%，较去年同期下降 3.69 个百分点，继续保持健康的资产负债结构。

公司始终将“新行业、新客户、新技术、新产品”作为核心发展方向，经过前期的持续投入，第二增长曲线业务已展现出良好的发展势头，成功推动业务从单一的消费电子领域，向“消费电子+卫星通信+智能汽车+N”的多元协同格局转型，为后续业务规模的进一步扩张奠定了坚实基础。公司深耕射频通信模组、商业卫星通信器件及组件、车载电子及高端元器件等核心业务，既是国家战略性新兴产业的重要组成部分，也是数字经济的核心赛道，近年来先后受益于新基建推进、5G-A 与 6G 技术研发提速、卫星互联网建设落地、智能网联汽车产业普及以及国产替代政策深化等多重利好，技术储备转化为实际产品的速度不断加快，产品落地量产、市场拓展落地、规模化盈利进程全面提速，长期发展的成长空间也随之进一步打开。在技术创新层面，公司坚持以市场需求和行业前沿技术为导向，积极联动国内外核心客户、顶尖高校与科研机构开展协同创新，围绕下一代通信技术、卫星互联、智能终端、车载应用等关键领域组建联合研发团队，集中力量攻克技术难题。目前，在高频射频器件、透明天线、卫星通信天线、高速连接方案以及高端 MLCC 等核心方向，已与多家行业头部客户建立起稳定的联合开发机制，多项合作项目顺利进入样品测试、性能优化或小批量试产阶段，为后续市场拓展储备了充足的技术与产品储备。

在产业布局方面，公司依托中央研究院为核心的全球研发体系，已建成 11 个研发中心、26 家子公司以及 5 个主要生产基地，业务版图覆盖 7 个国家的 17 个地区。自 2012 年启动海外布局以来，公司先后在 2019 年建成越南生产基地，2024 年完成越南基地扩建并新增墨西哥生产基地，同时启动深圳新总部基地建设，持续强化深圳技术研发与智能制造核心能力。这一完善的国际化布局，有效

对冲了国际贸易局势带来的不确定性，进一步加大海外产能建设及业务规模，为全球客户提供了更高效、更全面的产品与服务支撑。

当前 AI 智能硬件呈现端侧轻量化、算力高密度化、云边端协同三大发展趋势，推动天线、射频模组、元器件、结构件等核心零部件需求由通用性能标准，向高频高速、高集成度、高散热、强抗扰方向实现结构性升级。公司凭借多年积累的技术经验与长期前瞻性布局，深度契合智能终端在高速率、低时延、多频段通信方面的核心要求，为客户提供一体化的整体解决方案。在天线与射频模组方面，公司持续巩固移动终端天线制造业单项冠军的优势地位，为各类智能终端产品提供高性能的天线及射频配套方案；在高精密连接器方面，公司依托自身射频技术、磁性材料等技术优势，重点发展高速连接器、磁性连接器、BTB 连接器等高端细分领域，相关产品技术水平深受客户认可；在精密结构件方面，公司针对可穿戴设备场景研发出轻薄化、高强度结构件，同时推出适配高密度电池的不锈钢电池壳，精准匹配细分市场需求；在散热方案上，公司自主研发的 TIM 热界面材料、液态金属以及高分子高导热材料，已成功切入芯片封装散热片、TIM1 材料等核心领域，即将实现量产应用于 AI 终端产品。此外，公司成功进入北美新客户的 AI 硬件供应链，为其提供从天线、无线充电到精密结构件的全链条综合解决方案。LCP 及毫米波天线模组方面，公司自主研发的 LCP 薄膜通过了美国 UL（Underwriter Laboratories Inc.）认证，高频传输性能及可靠性等处于国内领先水平，已服务北美大客户，同时针对移动通信、智能网联汽车、卫星通信等相关领域的客户共同开展基于以 LCP 为代表的高分子先进材料的多种形态高性能毫米波天线解决方案的研究。公司 UWB 天线模组也已广泛应用于智能汽车钥匙、智能门锁、智能医疗设备、智能安防、智能音响等物联网及智能家居产品，有效拓展了物联网业务的应用边界。

通信应用方面，随着 5G-A 正式商用、6G 技术研发全面提速，再叠加人工智能、物联网、卫星通信等技术的深度融合，行业整体正朝着智能化、算力化、空天地一体化的方向加速演进。公司敏锐捕捉到这一行业趋势，重点布局柔性可重构天线、卫星通信相控阵天线、毫米波雷达缝隙波导天线、高频封装天线、光学透明天线、UWB 天线模组等核心技术领域，同时前瞻性布局 6G、数据中心、人工智能、人形机器人等前沿赛道，多项研发成果已进入系统仿真与验证测试阶段，可广泛应用于下一代移动通信、卫星互联、智能终端等多个领域，未来的应

用场景与市场空间极具潜力。在技术研发层面，公司紧跟行业高频高速发展方向，围绕射频天线及模组、无线充电、高速连接器、高端元器件等关键环节持续开展技术攻关：射频天线产品，成功研发高频低损耗高分子、陶瓷材料，大幅提升高频信号传输效率与集成度；无线充电产品，布局 NFC、Qi2.0/Ki、高自由度充电等新一代技术，满足多样化充电需求；高速连接器产品，研发轻量化、低 Dk 介电材料，保障高速信号传输的完整性与稳定性。

商业卫星通信业务方面，全球低轨卫星互联网星座建设已进入实质性实施阶段，直接带动地面终端设备需求迎来快速增长。公司已构建起“低轨地面终端核心器件 + 相控阵天线 + 高频高速连接器 + 精密结构件”的完整业务布局，与行业头部客户建立深度合作关系，成功切入全球低轨卫星产业链的高价值环节。目前，面向低轨卫星接收终端的相控阵天线模组已实现批量出货，持续保持在商业卫星领域的领先优势，并不断深化与北美两大客户的合作；高频高速连接器在卫星通信领域也取得了突破性进展，已成为公司第二大主要下游应用领域，依托全球化的研发与制造能力，为全球客户提供高质量的产品与服务。

公司智能汽车电子业务同样迎来高速发展期。随着汽车智能化进程不断加快与新能源汽车的全面普及，单车对天线等电子部件的需求显著提升，汽车天线技术也从传统的离散设计，逐步向多频段高度融合、智能波束赋形的方向演进，行业迎来全新的发展机遇。公司通过在天线与射频领域的技术积累，已成功进入国内外头部车企供应链，可提供车载天线、毫米波雷达模组、大功率无线充电模块、USB Hub 数据连接模块、定制化线束/连接器、Busbar、EMI/EMC 器件及精密结构件等全系列产品，汽车电子业务收入实现快速增长，预计成为公司重要的增量业务板块。

高端元器件（MLCC）业务方面，受益于 AI 服务器等新兴领域的快速发展，高容、宽温等高端 MLCC 产品的市场需求保持稳步增长态势。公司持续强化在材料配方、产品设计及工艺工程方面的研发能力，针对 AI 服务器场景完成高端 MLCC 系列化产品的全面布局：多款产品已实现稳定量产，产品性能与可靠性处于行业领先水平；大尺寸超高容产品的研发工作按计划推进，关键指标验证已顺利通过；目前，公司已累计获得相关专利 60 余项，成功填补国内高端 MLCC 技术空白，为国产替代进程贡献了重要力量。

透明天线技术作为公司的重要创新突破，已成功攻克高透材料与金属线路兼

容、复杂曲面成型、多频段信号耦合干扰等多项核心技术难题。公司自主研发的高透光、优电性能新型复合材料，已拓展至薄膜、玻璃、玻纤基材等多个领域，并持续优化材料的耐候性与加工适配性；针对北美大客户，已完成多批次产品送样，部分项目成功进入小批量试产评估阶段；在车载场景落地方面，与主流车企及核心玻璃供应商完成技术对接与样品送样，正在开展车载可靠性验证，为后续规模化应用做好充分准备。

在电子信息技术不断变革的快速发展浪潮下，公司坚守“致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值”的使命，重视研发投入，积极把握技术创新趋势，挖掘客户需求，将技术驱动融合在产品服务中，始终保持着源源不断的技术创新活力。截至 2025 年 12 月 31 日，公司共申请专利 5498 件；2025 年 1 月至 12 月新增申请专利 716 件，其中 5G 天线专利 238 件，LCP 专利 8 件，UWB 专利 18 件，WPC 专利 25 件，BTB 连接器专利 28 件，MLCC 专利 4 件，声学结构专利 169 件。报告期内，公司研发投入约 63,343.76 万元，占公司 2025 年营业收入的 7.11%，保持较高的研发强度，不断积累自身在基础材料、基础技术上的核心能力：

(1)基础材料：以村田、TDK、京瓷等优秀企业作为学习标杆，公司不断夯实高分子材料、磁性材料、陶瓷材料、散热材料等核心材料平台，加强在核心材料上的技术投入,持续提升材料核心竞争力。在高分子材料领域，公司具有深厚的研发实力和丰富的应用经验，我们开发的 LCP 薄膜、LCP 柔性覆铜板、MPI 柔性覆铜板等产品目前已在国内外消费类终端客户的 RF 传输线、毫米波传输线、UWB 天线等应用领域实现量产，公司可为客户提供从薄膜材料到模组的一站式解决方案，在高频高速方案中有着广泛应用；LCP 薄膜作为公司自主开发的核心材料之一，它具有耐高温且热稳定性能好、高频信号下传输损耗低、占用空间小等优点，在 5G 通信领域产品中已经大量使用，同时公司开展了 6G 前沿技术及先进材料的研发，应用前景会更加广泛。除了对已有产品的创新升级外，公司进一步优化 LCP 材料性能，深化其在商业卫星通信、智能汽车等领域的应用，联合客户开展基于 LCP 材料的高性能毫米波天线解决方案研究，以实现更广泛的商业价值和市场竞争力。在磁性材料上，公司有着深入而广泛的研究，已开发高频高功率低损耗磁性材料，是下一代无线充电技术的核心材料，在国内外客户移动终端的发射端均已有应用并供货；另外，磁性材料还可帮助提升天线、射频模组等多类产品

的竞争力，公司持续优化磁性材料性能，进一步拓展其在车载无线充电、卫星通信器件中的应用，为公司新兴业务的落地提供核心材料支撑。在陶瓷材料上，公司具备陶瓷材料和基础配方等研发能力，对 MLCC 等产品的生产具有重要意义，有助于降低生产成本，提高产品质量，增强公司产品的市场竞争力；公司研究的高频低损耗陶瓷材料在通信领域有很好的应用，特别是在高频通信和微波通信领域；通过对陶瓷材料应用的深入研究，可以进一步提升天线、阻容元件等产品性能，为客户提供更优质、高效的通信解决方案，多款高容 MLCC 产品已成功通过大客户测试，填补了国内高端 MLCC 技术空白。在散热材料领域，公司同时掌握基于液态金属和高分子材料的先进配方技术，精准匹配先进封装及算力芯片等高端应用场景的散热需求，已为北美客户提供核心芯片封装散热器件；未来，公司还将继续优化散热材料性能，拓展其在卫星终端、车载芯片、光模块等场景的应用，进一步深化与北美客户的合作，提升产品市场占有率。

(2)基础技术：公司依托以中央研究院为核心的全球 11 个研发中心，开发前沿技术产品。公司在射频领域拥有显著的研发实力和技术优势，围绕 5G-A/6G 的技术目标，积极开发柔性可重构天线、卫星通信相控阵天线、毫米波雷达缝隙波导天线、高频封装天线、光学透明天线、UWB 天线模组等。随着 5G-A/6G 技术的不断发展，对终端天线模组的要求也越来越高，天线模组需要能够支持更高、更宽的频带范围，以确保在各种通信场景下都能实现稳定的信号传输；而终端设备的不断小型化和轻薄化，对天线模组的尺寸和集成度也形成了严格的限制，对天线材料及工艺也提出了更高的要求，公司对 5G-A/6G 天线模组做了大量的研究工作，公司还在无线充电领域储备了 NFC 无线充电、Qi2.0/Ki、高自由度充电技术等；在高速连接器领域正在开展满足高频高速需求的轻量化、低 Dk 介电材料的研发。

展望未来，公司将继续依托全球化研发与制造体系，持续深化技术迭代与产品创新，不断优化 “存量深耕 + 增量突破” 研发布局，积极把握产业创新机遇，始终坚持对基础材料与基础技术的研发投入，进一步扩大新产品与新兴领域业务营收占比，有效降低单一业务与单一地区带来的经营风险。同时，公司将持续强化预算管理、风险控制，完善内部管理机制与运营措施，不断夯实核心竞争力、提升运营管理水平，积极履行 ESG 社会责任，坚持绿色可持续发展道路，稳步改善各项经营与财务指标，在全球产业数字化、智能化转型浪潮中持续创造

更大价值。

三、报告期内董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

- 公司第五届董事会第十三次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室召开。

1、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

2、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》；

3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

- 公司第五届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。

1、 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

2、 审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》；

3、 审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

4、 审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

5、 审议通过了《关于公司<2024 年内部控制自我评价报告>的议案》；

6、 审议通过了《关于公司<2024 年度可持续发展报告>的议案》；

7、 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

8、 审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》；

9、 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》；

11、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》；

13、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

14、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。

- 公司第五届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室召开。

1、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

- 公司第五届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室召开。

1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；

2、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；

3、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

4、审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；

5、审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》；

6、审议通过了《关于调整第四期股权激励计划授予价格的议案》；

7、审议通过了《关于第四期股权激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》；

8、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

- 公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室召开。

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》；

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

- 公司第六届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室召开。

1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。

（二）报告期内董事会对股东会决议执行情况

公司为广大投资者参加股东会表决提供便利，股东会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，严格执行股东会审议通过的各项决议，切实保护全体股东的合法权益和公司的整体利益。

（三）独立董事和各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，助力公司董事会工作的规范运作。报告期内，战略与可持续发展委员会共召开 2 次会议，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审计委员会共召开 6 次会议，提名委员会共召开 2 次会议，各专门委员会按各自职责分别召开会议，就公司的发展战略、财务状况、董事及高级管理人员的薪酬与考核等提出意见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

（四）独立董事工作情况

报告期内，所有独立董事均通过现场或通讯方式亲自参加公司召开的历次股

东会、董事会、专门委员会会议，充分行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，依靠自身的专业知识和经验，发挥独立董事的独立作用，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响；全面关注公司利益，积极推动公司的健康发展，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，通过审阅文件、与经营层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况；积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。

（五）信息披露工作

报告期内，董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所要求完成定期报告披露工作。公司在深交所信息披露考核中再次获评最高等级 A 级，已连续八年获得深交所信息披露考核 A 级评价。2025 年度，公司高效规范披露了 102 份公告及各类报告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过多种方式，及时了解投资者诉求和资本市场关注焦点，建立了良好的投资者互动关系。2025 年，公司累计开展业绩说明会、投资者调研及交流活动共计 4 场。回复互动易问答 288 次，并通过投资者热线、电子邮箱等方式与各类投资者保持沟通和交流。

四、董事及高级管理人员薪酬情况

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司薪酬管理相关制度的规定，结合公司 2025 年度实际经营业绩、个人绩效考核结果，并参考行业及地区的薪酬水平，公司确认了 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬情况。

五、公司未来发展的展望

（一）2026 年发展展望

2026 年，国际经济环境仍存在较多不确定性，伴随 AI 终端普及、卫星互联网规模化建设、智能汽车深度渗透及 5G-A 商用推进、6G 技术持续演进，下游市场需求稳步复苏与结构升级并行，公司所处行业整体景气度延续回升态势，产业

机遇与外部挑战并存。公司将继续坚持对基础材料、基础技术的长期稳定投入，持续锻造核心技术竞争力，深化精细化管理，全面提升运营效率与经营质量；同时积极应对外部环境变化，加速第二增长曲线落地见效，持续优化“消费电子+商业卫星通信+智能汽车+N”的多轮驱动增长模式，深化与全球核心客户的战略协同，加强人才梯队与组织能力建设，强化全面预算管控与资源统筹。此外，公司将重点加大战略产品线的投入与规模化拓展，稳步提升产品竞争力与市场地位，持续优化毛利率、净资产收益率等核心财务指标，进一步强化内部运营、风险管控与资源配置能力，不断增强抗风险能力，坚持降本增效、提质增效，推动公司经营业绩实现稳健持续增长。

1、在技术投入方面，公司将持续加强高分子材料、陶瓷材料、磁性材料、散热材料、等核心基础材料与相关基础技术研究，不断提升自主材料配方与工艺工程能力，以此全面提升公司在消费电子、商业卫星通信、智能汽车、AI 终端、数据中心等领域的 5G-A/6G 天线、毫米波天线、LCP 模组、高性能精密连接器、无线充电、高端 MLCC、UWB 模组、透明天线、相控阵天线等产品的综合竞争力。公司始终以客户价值为导向，以技术创新与产品迭代构筑竞争壁垒，同步加大基础材料与前沿技术预研投入，在持续深耕通信及消费电子主业的同时，全面深耕商业卫星通信、智能汽车等高成长赛道，并以前瞻性布局推进 6G、数据中心、人工智能、人形机器人、低空经济等新兴领域技术储备与产品开发，为公司中长期高质量成长打开空间。

2、在业务拓展方面，公司将继续巩固消费电子核心业务优势，同步加大力度推进第二增长曲线业务规模化落地，提升业务均衡性与抗风险能力。在消费电子领域，持续巩固天线及模组、无线充电、EMI/EMC 器件、高精密结构件、散热方案等产品的头部地位，积极拓展北美及境内新客户、新项目，提升高端产品与 AI 硬件相关产品营收占比。在新兴业务领域，加快推进高性能高速连接器、卫星通信相控阵天线、缝隙波导天线、UWB 模组、高端被动元件、汽车智能互联产品等业务的客户覆盖，推动新业务快速形成规模贡献。目前公司已完成商业卫星通信、智能汽车、AI 终端、数据中心、机器人等领域核心客户布局与重点产品导入，预计 2026 年及未来 2-3 年相关业务将成为公司重要增长引擎。

3、在客户合作方面，公司将持续深化与核心客户的战略合作，加强对下游技术路线、产品形态与市场趋势的跟踪与预判，强化“销售端—中央研究院—事

业部”高效协同，加快新技术、新材料、新产品在客户端的测试、验证与落地节奏。同时，公司将持续加大境内优质客户开拓力度，覆盖消费电子、商业卫星通信、智能汽车、数据中心、人工智能等领域优质客户。积极探索产业链收并购与战略合作机会，快速补强能力、完善国内业务布局，提升市场响应速度与综合服务能力。

4、在团队建设方面，公司将持续强化核心岗位能力建设与高端人才引进，加大关键技术人才、全球化经营人才与青年骨干培育力度，大力选拔任用高能力、高成就动机、高贡献的年轻人才，持续推进管理团队年轻化、专业化、国际化，打造适配全球化与高科技竞争的人才队伍。

5、在管理运营方面，公司将持续提升 EMT 集体领导与战略决策效率，以全面预算管理为抓手强化各事业部经营管控与目标落地，严格费用管控与资源投向管理，扎实推进降本增效；持续优化资金计划与现金流管理，加快资金周转、提升资金使用效率，合理统筹境内外资源配置，保障公司经营稳健、健康、可持续发展。

6、在激励与文化建设方面，公司将在已实施股权激励计划基础上，持续优化长效激励机制，重点激励核心奋斗者与高价值贡献者，深化共识、共创、共担、共享的合伙人文化，激发组织活力与全员创造力。

2026 年，尽管外部环境仍存在波动与挑战，公司管理层已做好充分应对准备，对完成年度战略任务充满信心。未来，公司将坚守长期主义，持续深耕基础材料与基础技术，不断拓宽技术护城河与产品壁垒，坚持技术引领与高效稳健经营，力争为全体股东创造长期、稳定、可持续的良好回报。

（二）2026 年公司发展面临的挑战及应对措施

公司未来经营业绩仍可能受到外部环境、行业竞争、汇率波动及内部管理等因素影响，主要不确定因素及应对措施如下：

1、经营风险

(1) 宏观经济与外部环境变化风险

全球宏观经济复苏节奏、地缘政治冲突、国际贸易政策变化等，仍将对产业链需求、客户投资节奏及公司生产经营带来一定不确定性，可能影响订单交付、营收增长与盈利水平。公司将持续深化与全球头部客户及境内优质客户的战略合作，加强对市场与需求变化的预判与快速响应，积极争取新项目、新份额；持续

加大研发投入与高端产品导入，提高新产品与高毛利产品营收占比，加快培育新增长点。在巩固消费电子移动终端优势的同时，进一步加大商业卫星通信、AI终端、智能汽车、数据中心、机器人等多元化领域布局，降低单一行业、单一区域、单一客户依赖，提升经营韧性。

(2) 行业迭代加速与市场竞争风险

公司所处行业及所经营业务具有技术迭代快、创新周期短等特征，下游需求结构持续升级，若产品创新、成本控制、交付能力不能持续跟上行业趋势，可能面临竞争力弱化与市场份额下滑风险。公司将保持高水平、高强度研发投入，坚持“材料->零部件->模组”一体化能力建设，以技术领先保障产品竞争力；持续优化产品结构，淘汰低毛利产品，聚焦商业卫星通信、AI 硬件等高价值方向；持续推进精益生产、智能制造与全球化产能布局，强化成本、质量、交付核心竞争力，巩固并提升行业头部地位。

(3) 汇率波动风险

公司海外收入占比较高，出口销售与部分原材料进口以美元等外币结算，国际汇率波动可能对公司营收、毛利率及净利润造成一定影响。公司将持续完善外汇风险管理体系，加强汇率趋势的前瞻性管理，合理运用外汇对冲工具降低汇率波动影响；优化境内外采购、生产、销售与结算布局，提升自然对冲能力，稳定经营业绩。

2、管理风险

随着公司业务规模持续扩大、全球化布局深化、新兴业务快速拓展、子公司与产品线不断增加，组织架构、管理流程、内控体系、人才供给需持续适配快速发展节奏，若管理能力提升滞后于业务扩张速度，可能带来运营效率下降、内控落地不到位等管理风险。公司将持续优化治理架构与管控模式，完善全球化运营管理体系；加强对子公司、事业部的合规管理与经营督导，定期开展管理培训、内控自查与流程优化；严格执行全面预算管理、绩效考核与风险管控机制，保障公司整体战略高效落地；持续推进组织提效与人才梯队建设，以管理升级支撑业务高质量发展。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十七日